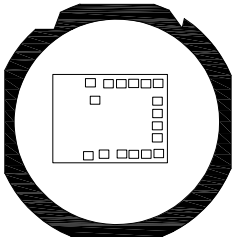
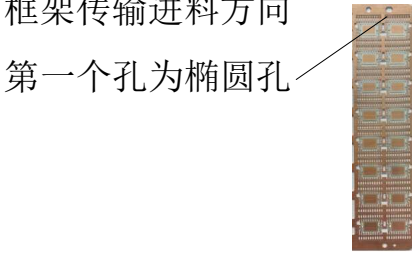
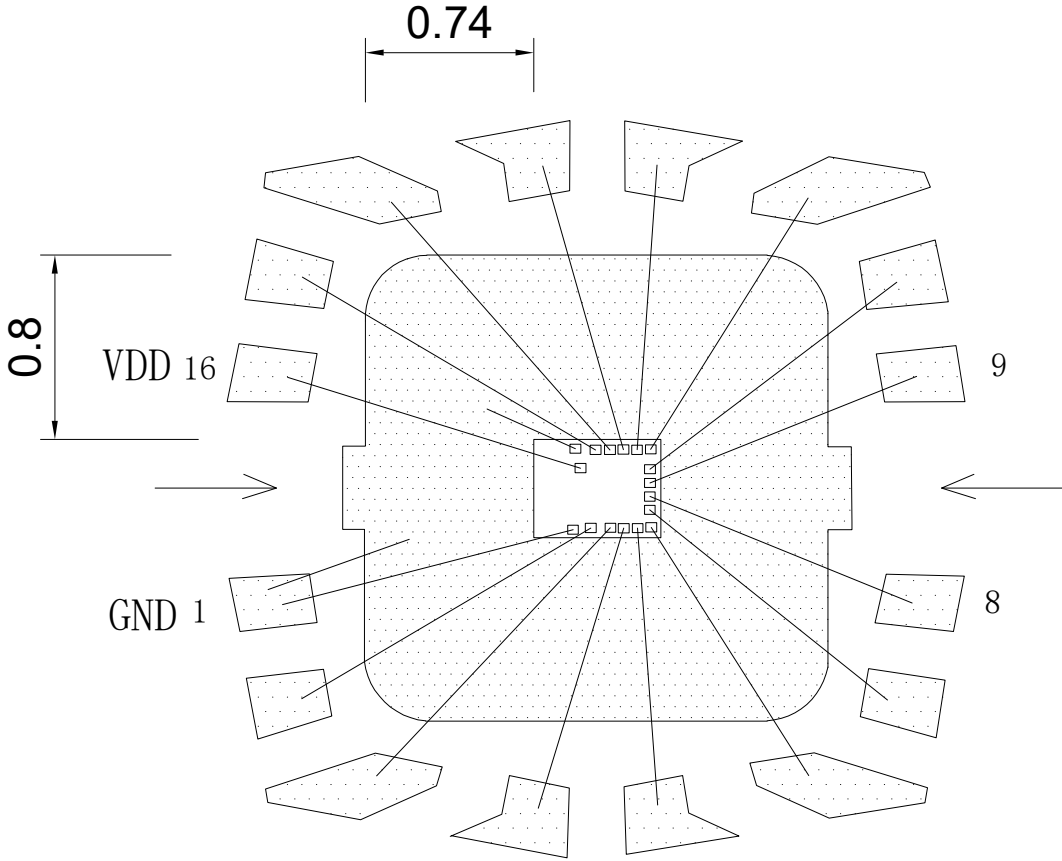


江苏芯丰集成电路封装压焊图		图号:314BD002	版本	A. 1
贴片方向（芯片与片环方向示意图） 	框架传输进料方向 第一个孔为椭圆孔 	更新为小基岛框架，减薄厚度为300um	2023. 9. 27	
		备注及特殊要求（Remark&Special Instruction）		



请仔细核对焊线位置，以及材料选择。如无误
请签字回传，谢谢！

客户回签：

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照射紫 外线，如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input type="checkbox"/> 蓝膜	风险监控： 低风险		<input checked="" type="checkbox"/> MSL3 <input type="checkbox"/> MSL1	
单顶针	多顶针	点胶	画胶					<input type="checkbox"/> 车规	
	/		/						
产品型号 (Product Type)：		HS9000P-P16		线材直径 (Wire Diameter)：		银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)	300±10um	
芯片名称 (Die Name)：		HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening)：		50.35×50.35um	装片胶 (Epoxy)	首选	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸： (Die Size)：		0.5548×0.4332mm		最小压焊间距 (Min Pitch)：		59.85um		备选	/
封装形式 (Package Type)：		SOP16L(9.9×3.9×1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start)：		PIN1	塑封料 (Molding Compound)	首选	EMC-GR710G GN
引线框 (Lead Frame)：		SOP16L(12R)(80×80) -QP		焊线总数 (Quantity of Wire)：		18		备选	/
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)：		雾 锡		最长线长(Length of longest Wire)：		1.49/22.352mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)		8寸/刀片开槽+刀片切割		顶层铝厚 (Top Al Thickness)：		1um(3层)	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
吸嘴 (suction nozzle)		RTN-014-014		切割道 (Cutting Way)		60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
拟制 Prepared by		钱培丽 2022.6.8		审核 Checked by			批准 Approved by		